

无锡市建设项目建设工程规划许可证批前公示

根据城乡规划管理有关规定，现对芯钛半导体（无锡）有限公司半导体湿法设备研发制造项目建设工程规划许可证进行批前公示。

一、项目概况

该项目位于惠山区堰桥街道堰裕路与刘仓纵二路交叉口西南侧，建设单位为芯钛半导体（无锡）有限公司。

项目总可建设用地面积约3.56万平方米，用地性质为工业用地。

项目总建筑面积约5.75万平方米，容积率、建筑密度、绿地率等相关指标符合规划要求。（具体详见规划公示图）

二、公示地点和时间

公示地点：

- 1、项目所在地现场；
 - 2、无锡市数据局(无锡市政务服务管理办公室)网站 (<http://bigdata.wuxi.gov.cn>)；
 - 3、无锡市自然资源和规划局惠山分局公示栏(文惠路16号)；
- 公示时间：2026年6月23日---2026年7月2日

三、联系方式和意见反馈

联系地点：无锡市自然资源和规划局惠山分局（无锡市惠山区文惠路16号）

邮政编码：214174

联系电话：0510-83598309

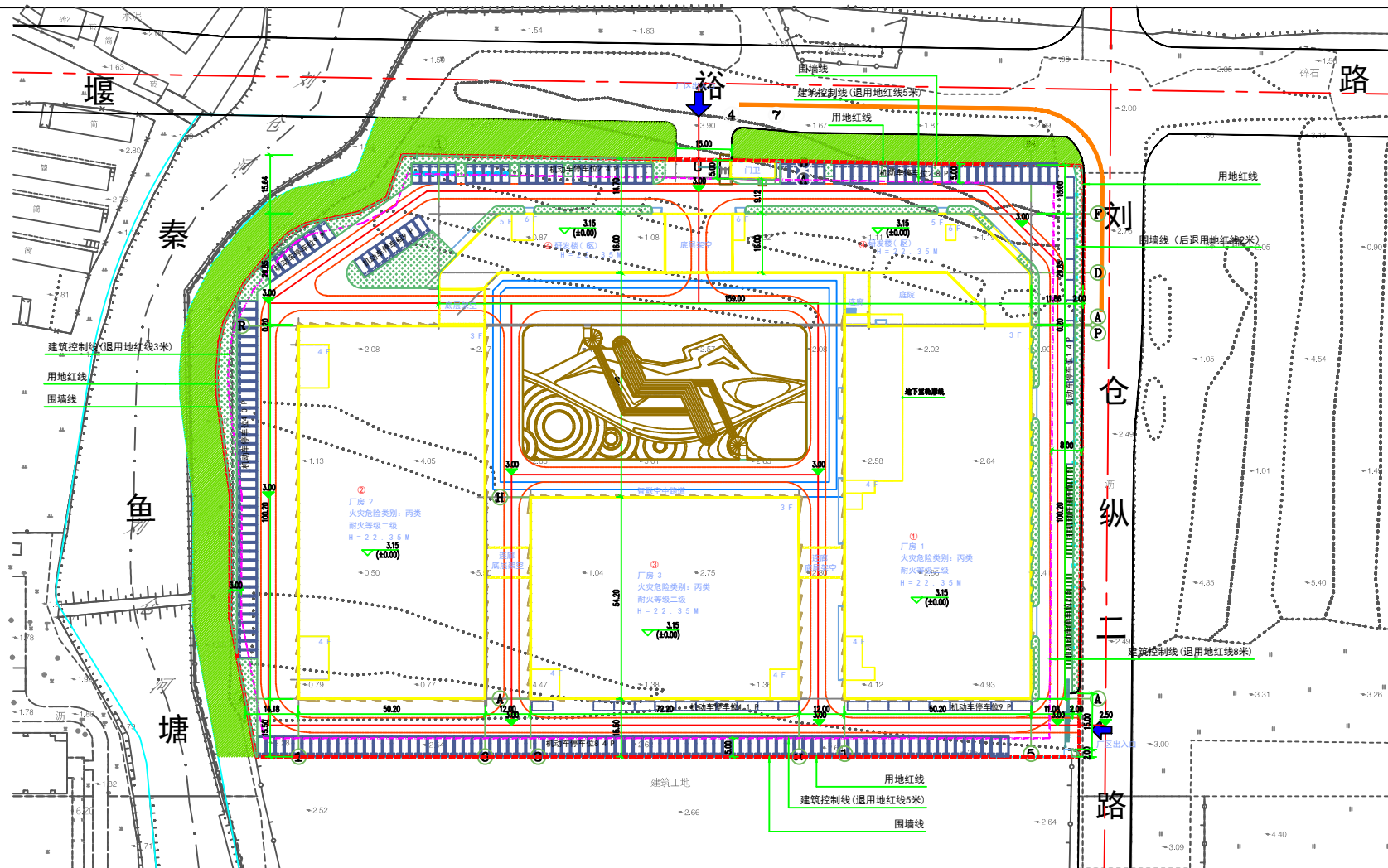
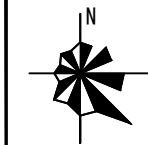
电子邮箱：ghjhsfj@163.com

批前公示旨在征询公众意见，并非最终审批结果。公示期间，如有意见或建议，请反馈给我局（请注明本人身份、联系电话或地址）。

无锡市数据局
2026年6月22日

半导体湿法设备研发制造项目

总平面图



鸟瞰图（仅为示意）



单体效果图（仅为示意）



单体效果图（仅为示意）